**英特尔宣布扩容成都封装测试基地**

来源：中国电子报、电子信息产业网 作者：姬晓婷

2024年10月28日，英特尔宣布扩容英特尔成都封装测试基地。在现有的客户端产品封装测试的基础上，增加为服务器芯片提供封装测试服务，并设立一个客户解决方案中心，以提高本土供应链的效率，加大对中国客户支持的力度，提升响应速度。相关规划和建设工作已经启动。

根据英特尔成都基地的扩容计划，其新增产能将集中在为服务器芯片提供封装测试服务，以响应中国客户对高能效、定制化封装解决方案的需求。即将设立的英特尔客户解决方案中心将成为推动企业数字化转型的一站式平台，携手客户、生态系统伙伴为行业客户提供基于英特尔架构和产品的定制化解决方案，加速行业应用落地。

英特尔公司高级副总裁英特尔中国区董事长王锐表示：“中国不断推进的高质量发展和高水平对外开放，是英特尔在中国市场长期发展的基础和动力。英特尔植根中国、服务客户的战略不变。此次成都基地扩容将使英特尔更聚焦本土需求，整合资源，更快地响应中国客户的数字化和绿色化转型，为可持续发展的数字经济注入新动能。”

英特尔成都工厂于2004年奠基，2005年一期竣工，2006年二期竣工，2009年第三次追加投资，并整合在上海的封装测试产能。2012年下线第10亿颗芯片，中国西部地区分拨中心落户，2014年全面升级，首次引入最新的高端测试技术，2016年实现集芯片封装测试、晶圆预处理、高端测试技术于一身的高科技制造集群。

英特尔产品（成都）有限公司位于成都高新综合保税区，目前是英特尔全球最大的芯片封装测试中心之一。英特尔全球半数以上的移动处理器和半成品晶片，产自英特尔成都。英特尔还在成都建成了晶圆预处理生产线，成为英特尔全球三大晶圆预处理工厂之一。